

性能特点

- 单组分室温潮气固化，便于操作
- 刺激性气味小，对金属无腐蚀
- 卓越的耐高低温性，极好的耐气候性能
- 卓越的化学和机械稳定性
- 与大部分介质粘接力强

产品描述

PAKCOOL® TC-115 是单组分、室温潮气固化液体导热硅胶，具有对电子器件导热和粘接功能。可在短时间内固化成硬度较高的弹性体。固化后与其接触表面紧密贴合以降低热阻，从而有利于热源与其周围的散热片、主板、金属壳及外壳的热传导。本系列产品具有导热性能好、绝缘性能好以及便于使用等优点，可广泛用于个人便携式电脑的集成电路、微机处理器等的封装。

本产品对包括铜、铝、不锈钢等金属有良好的粘接性，固化形式为脱醇型，对金属和非金属表面不产生腐蚀。

典型应用

- 太阳能面板
- 功率模块
- 集成芯片
- 电源适配器
- 汽车电子
- 通讯设备
- 计算机及其附件

固化时间

• 固化时间与环境湿度/温度及涂抹的深度有关，建议涂抹的深度不大于 5 mm，表干后完全固化的时间大概为 7 天。

技术参数

特性	TC-115	测试方法
基材	Silicone RTV-1	--
颜色	白色	Visual
状态	不可流平	--
导热系数 (W/m·K)	1.5	ASTM D5470
表干时间 (min @ 25°C 50%)	4	GB/T 13477.5
密度 (g/cm ³)	2.60±0.10	ASTM D792
硬度 (Shore A)	76	ASTM D2240
无底涂粘接强度 (MPa)	2.2	Aluminum lap shear
储存时间 (@<20 °C)	6 months	--

本数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。

使用方法

- 涂胶前，用溶剂将元器件表面擦拭干净并晾干
- 使用时带防护眼镜和防护手套
- 使用时环境需通风

包装储运

- 本产品可提供 330mL 胶瓶包装或根据客户要求定制包装
- 避光储存于干燥凉爽的地方
- 装有本产品的密封胶瓶应水平放置以减小沉淀及分离的产生

本说明书的数据是实验室条件下获得。但因为使用环境、工艺等差异，所以不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的的产品。如您在使用本产品中出现任何问题，欢迎和我司技术部门联系，我们将尽力为您提供帮助。